1/4 整理器号 K - 3072/

仕 様 書 インレット 09. 03. 26 09. 03. 26 AC-M43松原 石原

1. Scope 適用範囲

This specification applies to inlet, used in electronic equipment. この仕様書は電子機器一般に用いられるインレットについて規定する。

2. Applicable safety standard 適用安全規格

UL. CSA. SEMKO. CCC

3. Acquired safety standard approval 取得安全規格

UL : E101143 CSA NRTL/C : LR36166

SEMKO : 817722 CCC : 2009010204333815

4. Construction (Dimensions and materials) 構造(寸法・材料)

外形図面による

Refer to outline drawing 5. Characteristics

Units and values indicated with { } in this specifications are the former units and specified values. この仕様の中で{}をつけて示してある単位及び敷値は、従来単位によるものであって、規格値である。

Standard atmospheric conditions

Unless otherwise specified, measurements shall be made at any combination of temperature, humidity and sir pressure

within the following limits;

Ambient temperature : 15 °C to 35 °C Relative humidity : 25 % to 85 %

Air pressure : 860 hpa to 1060 hpa If there may be any doubt on the results, measurements

shall be made within the following limits;

Ambient temperature : 20 ± 1 °C Relative humidity : 63 % to 67 % : 860 hps to 1060 hps Air pressure

Operating temperature range

Preservation temperature

〇使用温度範囲

②標準状態

にて行う。

特に指定がないかぎり,常復(温度 15~35 ℃),常提

ただし、判定に疑義を生じた場合は、程度 20 ± 1 ℃、 程度 63~67 %, 気圧 860~1060 hpaにて行う。

(薩度 25~85 %),常気圧(気圧 860~1060 hpa)

E 1 Dlastminel characteristics

	l Electrical cha: Items 項目	Conditions 条件		Specifications 規格
1	Rating 定格		UL CSA SEMKO CCC	250 V 5 A a.c. 250 V 2.5 A a.c.
2	Contact resistance 接触抵抗	Test current: 1 A d.c. Open circuit test voltage ** 5 V d.c. Refer to the test method in item 5. Compatible connector(1- 適合コネクタ (SB-		50 mQ or less 以下
3	Insulation resistance 絶縁抵抗	500 V d.c. shall be applied for 1 min after which measurement shall be made d.c. 500 V, 1分後	Between terminals 樂子間 Between terminals and body 端子一本体間	1000MΩ or more 以上
4	Dielectric Strength 耐電圧	Apply 2 000 V a.c. voltage for 1 min between conductors. a.c. 2 000 V, 1分間印加する。 Trip current : 2 mA 感度電流	Between terminals 繼子問 2000 V a.c. Between terminals and body 繼子一本体閱 2000 V a.c.	No damage such as dielectric breakdown etc. 熱鉄破壊等の異常がないこと。
Б	Temperature rise 温度上昇	Apply rated voltage and current to pin and terminal part. ピン及び端子部に定格電圧,電流を通電する。		30 ℃ or less 以下

5.	2 Mechanical cha	racteristics 機	械的性能		
	Items 項目		Conditions 条件		Specifications 規格
_	Andrew Control of the	Tensile 引張り強さ		AND THE REAL PROPERTY OF THE P	
1	Terminal strength 端子速度	Nominal cross	Nominal wire diameter of round cross section	Tensile strength 引張り力(N)	There shall be no damage to the
		公称新面積(mm²) s ≦ 0.05	断面が円形の公称線径(mm) d ≦ 0.25	1	terminal such as cracks, looseness or
		0.05< s ≤ 0.1	0, 25 < d ≦ 0.35	2. 5	play. Electrical
		0.1 < s ≤ 0.2	0.35< d ≦ 0.5	6	and mechanical
		0.2 < s ≤ 0.5	0.5 < d ≤ 0.8	10	characteristics shall be satisfied.
		$\begin{array}{c c} 0.5 < s \leq 1.2 \\ 1.2 < s \end{array}$	0.8 < d ≦ 1.25 1.25 < d	40	端子に亀裂,ゆるみ,
		The specimen shall be	sustained and the load spe	cified above shall	ガタ等の異常がなく。 機械的・電気的性能
		be applied to the ter from the body for 10	minal 2 mm from the body to	a direction away	を満足すること。
	В		張り力を本体から 2 mmの位置	に囃子の引出し方向	
		Pushing 押し独さ			
			iominal wire diameter of	Pushing strength	
	=		round cross section 新面が円形の公券線径(mm)	押力(N))
		公称新面積(mm²) s ≤ 0.05	所国か円形の公外無径 (mi) d ≦ 0.26	0. 25	
		0,05< s ≤ 0.1	0,25< d ≤ 0.35	0.5	
		0.1 < 8 ≤ 0.2	0.35< d \(0.5		
		$\begin{array}{c c} 0.2 < s \le 0.6 \\ 0.5 < s \le 1.2 \end{array}$	0.5 < d ≤ 0.8 0.8 < d ≤ 1.25	2 4	
		1, 2 < s	1, 25 < d	8	
		shall be applied to t toward the body for 1	力を本体から 2 mm の位置にオ	ody to a direction	
		Bending 曲げ独さ		8	
		Component body shall to the floor. A stati the terminal acting i the inlet shall then of 90° in the vertic position in 2 or 3 s	which can be bent by finge be fixed so that terminal c load specified below shal n a direction away from the be inclined through an angl al plane and then returned then the body shall be incl	are perpendicular l be applied to body. The body of e to its initial ined to the	There shall be no damage to the terminal such as cracks, looseness or play. Electrical and mechanical
		reversed direction the sinitial position in	rough an angle of 90° and t 2 or 3 s.	nen returned to it	characteristics shall be satisfied.
	3	(機で曲げることができ		فعالة ستلايمون بلساطور بلاسيم	増子に亀裂, ゆるみ。
	程藻	質量のおもりを端子の気	8品本体を固定し,下記に規定の 6増につり下げる。部品本体を 元の位置に戻す。 さらに逆方↑	垂直面内で2~3秒間	ガタ等の異常がなく、 機械的・電気的性能 を満足すること。
0	00	Section area	Nominal wire diameter o	f Beding	
6-	09	conefficient 断面係数(mm³)	round cross section 断面が円形の公称線径(mm	strength) 曲げ力(N)	
=17.	· 查	$ \begin{array}{c} 2x \le 1.5 \times 1 \\ 1.5 \times 10^{-3} < 2x \le 4.2 \times 1 \end{array} $		0. 5 1. 25	
213	F	$\frac{1.5 \times 10^{3} < 2x \le 4.2 \times 1}{4.2 \times 10^{3} < 2x \le 1.2 \times 1}$		2.5	
	,	$1.2 \times 10^{-2} < 2x \le 0.5 \times 1$	0 ⁻¹ 0.5 < d ≦ 0.8	5	
_		0.5×10 ¹ <2x≤1.9×1		10	
	(Continued) 表項へ続く	1.9×10 ⁻¹ <2x	1, 25 < d	20	
	V2.M)	Lancard Control of the Control of th		_	

性 様 書 インレット AC一M43

整理番号

1/4

K-3072

整理番号2/4K-3072

性 様 * インレット A C - M 4 3

承 認 海 査 09.03.26 09.03.26 作 成09.03.26 松原 石原

П	Items 項目	Conditions 条件		Specifications 規格
1	Terminal strength 端子強度	2: section area coefficient at to the bendit 断面係数 (man ³) 曲げ軸に垂直/	な板の厚さ (man)	
		lead wire diameter b: sides of rect y 一ド線径 (am) < 形断面の他収 for other procedures, refer to IBC Pub. 68-2-21.	angle cross section 1の寸法 (mm)	
	1	その他 JIS C 0051に準拠する。		
		Caulking カシメ強さ		
		The moment of force shall be applied to the term The force is the same as above tensile strength arm.	with 0.01 m moment	
		モーメントの腕の長さ 0.01 m のとき,引張り力と同 10 生 1 秒間加える。	じ力のモーメントを	
	Insertion and	Measurement shall be performed after inserting and removing a compatible connector 3 times.	Insertion force 排入力	60N(6.12kgf) or less 以下
2	removal force 挿入・抜去力	適合コネクタを用い3回挿抜後に測定する。	Removal force 抜去力	10N(1.02kgf) to 50N(5.1kgf)
3	Degree of prying force こじり強度	After affixing to the compatible chassis, inser- connector and apply 1 N * m {10.2 kgf * cm} force direction for 15 s. 適合シャーシに取り付け固定後,適合コネクタを挿入 1 N * m {10.2 kgf * cm} の力を15秒間加える。	toward X and Y	No damage or cracking. Clauses 5.2.2 and 5.1 shall be satisfied. 割れ、損傷等の異常がな いこと。4.2.2及び4.1 項を満足すること。
4	Degree of installation force 取り付け強度	After affixing to the compatible chassis, apply statistic load for 1 min from the insertion direction body. 適合シャーシに取り付け固定後, 挿入方向から本体に 静荷東を1分間加える。	ection to the main	Without crack or damage etc. 割れ,損傷等の異常が ないこと。
6	Strength of connected portion 取付け部強度	After affixing the inlet to the compatible chas apply load of P = 100 N {10.2 kgf} for 1 min fi direction to the main body. 下図のように適合シャーシゲージにインレットを取り方向より P = 100 N {10.2 kgf} の荷重を1分間加え	rom arbitrary 付付,本体に任意	The inlet shall not drop out from the compatible chassis. インレットが 適合シャーシから脱落しないこと。
			,	

Items	Conditions	Specifications
項目	条件	規格
1 Solderability はんだ付け性	Terminal with tin plating/solder plating 動力き・はんだめっき端子 Refer to Sony Technical Standard SS-00126-1 "Parts Design Standards - Test Method for Electronic component PART 1 Solderability Test Method" ソニー技術標準 SS-00126-1「ソニー部品設計基準-電器部品試験方法 PART 1 はんだ付け性試験方法」による。	(1)Solder wetting time shall be 3 s or less はんだ離れ時間3.0秒以内 (2)A new uniform coating of solder shall cover a minimum of 95 % of the surface being immersed. はんだ漫波面積の95% 以上新しいはんだで濡れ ていること。

	Items 項目	Conditions 条件		Specifications 蝦格
2	Insertion and removel strength 神抜強度	Insertion and removed shall be made 1 000 times rated load and 3 000 times without load at rated voltage and current. Insertion and removal speed shall be 15 cycles/min. 定格養圧・定格電流で 定格養費1000回+無負荷3000回挿入後測定する。 ただし、挿抜速度は15回/分で行う。	Insertion force 挿入力 Removal force 技去力 Contact resistance 接触抵抗 Dielectric strength 耐電圧	60 N or less (6.12 kgf) 以下 10 ~ 50 N (1.02 ~ 5.1 kgf) 30 mQ or less 以下 i 500 V for 1 min 1分間 Mechanical characteristics, and electrical characteristics shall b satisfied. 機械的、電気的性能を満足すること。
3	Damp heat 耐複性	After 96 h of aging in a constant temperature temperature of 40 ± 2 ℃ and humidity of 9 leave as is for 1 h at normal temperature a measurement shall be made. For other procedures, refer to IEC Pub. 68-2度 40 ± 2 ℃、 極度90~96 %の恒温榜中に9 常進芳海中に時間放置し測定する。その他JIS C 0020に準拠する。	0 % to 95 %, and humidity then 2-3.	Mechanical characteristics, and slectrical characteristics shall b satisfied, 機械的、電気的性能を満足すること。
4	Dry heat 耐熱性	After 96 h of aging in a constant temperatu temperature of 70 ± 2 ℃, leave as is for temperature and humidity then measurement s Por other procedures, refer to IEC Pub. 68- 温度 70 ± 2 ℃の恒復槽中に96時間エーシング 1時間放便し測定する。 その他JIS C	1 h at normal hall be made. 2-2.	
5	Cold 耐寒性	After 96 h of aging in a constant temperatu temperature of -25 ± 2 ℃, leave as is for temperature and humidity then measurement s Por other procedures, refer to IEC Pub. 68- 組度 -25 ± 2 ℃の恒原槽中に96時間エーシンク 1時間放便し測定する。 その他JIS ©	1 h at normal shall be made. 2-i.	Mechanical characteris
6	Change of temperature 濃度サイクル	The injet shall be subjected to 5 successive temperature cycles, each as show in the tab. Then the injet shall be maintained at a state condition for 1 h, after which measurement 下記表を1サイクルとして5サイクル行う。その4 放置し測定する。	ole below, indard atmospheric shall be made.	tics, and electrical characteristics shall lastisfied. 機械的,電気的性能を満足すること。
7	皇梁	湿度 放置 1 -25 ± 3 ℃	ation 【時間 30 min 分	
-	09	condition 常趣 3 70 ± 2 ℃	30 min 分	
4	音/	4 Standard atmospheric condition 常湿 1	10 to 15 分	

性 *** *** インレット AC一M43

整理番号

2/4

 $\frac{K-3072}{y=-(*)6*}$

整理器号

K - 3072/

仕 様 書インレット AC-M43

09. 03. 26 09, 03, 26 09, 03, 26 松原 石原

	Items 項目	Conditions 条件	Specifications 規格
7	Resistance to soldering heat はんだ耐熱性	For procedures other than those specified below, refer to 18C Pub. 68-2-20 下記の他はJIS C 0050による。 Solder bath method デインプの場合 Preheat :100 to 110℃, 30 参 Solder temperature :260 ± 5 ℃ 時間 Immersion depth : Up to the surface of the board 浸液深き 蒸板面まで Thickness of heat shunt (Printed wiring board) : 1.6 mm 熱産散板(プリント配線板)の厚さ Material : 1.6 mm かまままままままままままままままままままままままままままままままままま	Without deformation of case and excessive looseness of terminals. Electrical characteristics shall be satisfied. 外機の変形および端子などの著しいガタがなく、電気的性能を構足すること。
8	Resistance to flux penetration 耐フラックス。上がり	For test method, refer to page 3/4 "Test Method for Resistance toFlux Penetration" (大阪大阪 1/4 ページの「耐フラックス上がり試験方法」による。 Nominal thickness : 1.6 mm (P任-859) 基板厚さ Measure to prevent flux migration フラックス上がり対策 Notice : 注意李項	Hiectrical characterist- ics and Mechanical char- acteristics shall be satisfied. 電気的性能および機械的 性能を満足すること。
9	Weight 質量		Reference value (参考値) 4.5 g

6. Contact resistance test method

(Apply the following procedures in spite of the difference of the configurations.)

Insert the compatible cord connector into the inlat as shown in the figure below. And measure the contact resistance by the voltage drop method.

5.接触抵抗試験方法

(圏と形状が異なる場合も下記に準ずる。)

適合コネクタをインレットに挿入し, 電圧降下法により 接触抵抗を測定する。



TEST METHOD FOR RESISTANCE TO FLUX PENETRATION 耐フラックス上がり試験方法

- I Materials
- (1) Solder
- Refer to IEC Pub. 68-2-20, Appendix B.
- (2) Flux

JIS-64MS-5 KOKI COMPANY LIMITED. CF-330VS TAMURA KAKEN CO., LTD or an equivalent flux shall be used. The flux used shall consist 15% by weight of rosin.

1. 材料

- (1) はんだ
- IIS Z 3282に規定の63%Snはんだ(H63A)もしくは、60% Snはんだ (H60A)
- (2) フラックス

弘輝製 JS-64MS-S. タムラ化研製 CF-330VS もしくは それと開築品で、間形分離度は重量比15%

Flux フラックフ	ς.	Specific gravity 比重 (20℃)
KOKI COMPANY LIMITED	JS-64MS-S	0.815~0,825
TAMURA KAKEN CO., LTD	CF-330VS	0, 824~0, 834

(3) Printed wiring board

A board specified by NEMA(XPC) or it's equivalent board. (Board shall be single-sided and its nominal thickness shall be specified in Clause "Resistance to flux menetration with a copper foil thickness of 35 um.)

The position of mounting holes for test component shall correspond exactly to the terminal configuration so that terminals fit exactly into the holes. Hole size shall be as specified. If not specified, hole size shall exceed the diameter (or exterior dimensions in the case of non-circular terminals) of terminals by 0.2 mm to 0.4 mm. Unless otherwise specified, the conductor land size shall exceed the diameter (or dimensions) of holes by 2 mm to 4 mm.

(3) 基板

JIS C 6485で規定されたプリント配線板(P.P)もしくは、 これと関等品(摩さは「耐フラックス上がり」の条件に 規定のもの 35μm 片面鋼箔)に、部品のリード位置に対 応して、特に相定のない場合は(リード形状+0.2~0.4)mm の穴をあけたもの。

(取付穴寸法補定がある場合はそれによる) パターンランドは特に措定がない場合は、 め(リード外径+2~4)mmとする。

II. Test

- (1) The printed wiring board specified in Clause 1 shall (1) 1項指定の基板を1項指定のフラックス被中に基板の製面 be fully immersed in the flux specified in Clause 1 for 3 to 5 s. The boad shall then be taken out of the flux.
- (2) The test components, its electrical characteristics (2) 性能の初期測定を終了した部品をすみやかに、かつ、浮き and mechanical characteristics specified in this specification having already been measured, shall be inserted completely into the board as soon as the board is removed from the flux.
- (3) Either the flux both method or the foaming method shall be used to apply flux a second time to the board. In either case, flux shall not come into contact with the component side surface and fluxing time shall be 3 to 4 s.

Note: After fluxing, if preheating is necessary before mounting, then the surface of the solder side shall be heated to 75 °C to 90 °C for 1 min or less.

(4) Using an automatic soldering system or a hand dipping system, the boad shall be soldered up to the component side surface (but the solder shall not come into contact with the component side) for 5 ± 1 s at 250 °C to 260 °C.

2. at 10

- を全面3~5秒間浸渍し、取り出す。
- がないようにマウントする。
- (3) マウントした基板に、まず、基板上面スレスレまで指定の フラックスを筆布する。(フラックス整布は,発砲式また は静止被中浸漬により3~4秒間行う)
 - 注: フラックス義布後,プレヒートを行う場合は,プレ ヒート時間は1分以内で基板のはんだ付面側の表 面温度が75~90℃になるようにする。
- (4) その後自動はんだ付装置もしくは手ジャブにより、250~ 260℃ のはんだ浴中で5±1秒間浸漉しはんだ付けする。 この時の授債深さは基板上面スレスレに達するように行

性 *** *** インレット AC-M43

整理器号

3/4

K - 3072

整理番号	4/4	供、	様 書 レット	承 認	審 查	作成
K - 307	$2 \wedge $		M 4 3	09.03.26	99.03.26	09. 03. 26
			101 1 0	14 DK	至力	石原
(5) The board shall be su conditions for 24 h o Tests shall then be c ① Measurement of ch ② Visual inspection portions on or wi has been removed This inspection i into the test com	r more after the arried out as spearacteristics as of contacts and thin the test com from the board and to see if flux	soldering. cified below; specified any specified sponent after it d disassembled.	(5) はんだ付けが終わ 下記項目を関べる。 ① 規格に規定の付 ② 部品を解体し、 規格に規定した	: 能の測定 接点および「i	耐フラックス。	上がり」の
7. Marking The following items si legibly on the inlets 1.1 Manufacturer's name permitted) or trade- 7.2 Month and year of pr 7.3 Country of origin 7.4 Part number of SONY 7.5 Items designated in 1 7.6 In case of halogen fi 8. Approval 8.1 Prior to delivery, si following to the locator of the second of the se	or each unit pack ack nark duction code (in the acquired safe ee or load free, applier shall sub il purchasing dep	facturer's name cluding Lot No. ty standard indication is no mit the)7.2 製造年月または略- 7.3 原産園 7.4 都品番号 7.5 取得安全規格に基-	ること。 裏あるいは略が サ(ロット番号 づく指定表示の プリーの場合 なち下記のもの	も含む) も含む) g 目 、それを意味	する表示
QC process o QC 工程表(工	hart (Process co.		copy		2	
Approval sheets shall lis a) All items designated in Furthermore, dimension employed, finish and so b) When materials such as other inflammables are clearly indicated. 1) Numcs of materials 2) Trade name and type	n the specificat s in detail, mat- pecifications. plastics, rubbe: used, the follow and manufacturer	ion. srials r, fiber and wing shall be	また納入仕様書は次の3 〇本仕様書に規定された 寸法、構成部品の材質 〇プラスチック・ゴム・フ 材料名・材料メーカと ・UL File No. を明記	・規格・処理に ・規格・処理に ファイバ等の可 商品名と型名・	いて記載し、細うついて明記す。 「燃性材料につ	る。 いては
3) Flammability classi 4) UL file No. c) For tin or zinc plated products, specify whis d) If requested by SONY, plant and person (s) r in the approval sheet e) Specifications, which requested by SONY, sha and also listed on the 8.2 Prior to the alterati (including materials manufacturing plant a supplier shall consul as specified in Claus 8.3 For procedures for fi	(including chroikers prevention sinclude name of seponsible for quor in an attached are different from the approximation of the approximation of the approximation of the septiment of the septim	methods. manufacturing mality control is sheet. mathose is lose in call mathose in call mathor process etc., course mathor matho	8.3 検定申請に関する手#	(ついて明記す) (方)・品質管理 (こる箇所は赤△ (D)、製造所・製委の上8、1項の更 売きについて6	る。 責任者を明記: 印を付け、さら 造価にて検定を は、ソニー技術	または ちに表紙 更受ける 権遵SS-00
(approvalappilcation a SS-00233-3"Specificat For Electrical Parts Japanese Suppliers)"	ion Electrical Pa	rte-PART3 Guide	1 233-1「納入仕様書-1 のこと。	■ 双 帯 品 一 パー	一ト1発出要領	日」を参照

NOTICE ON MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESS 構成部品の材料・処理 に関する注意事項

Don't change written contents and append them ●記載内容を変更せず添付する

- 1. この部品には SS-00269-1*に指定する物質を含んだ材料は、使用してはならない
- 2. SS-00259-1*に指定する物質の使用有無については、納入仕様書にて明らかにすること
- 3. 都品の分別処理を容易にする為、プラスチック材料都に材料記号を表示すること 表示する記号と詳細は、SS-00195-1「プラスチック製部品の材料表示規定」を参照すること ただし、表示が困難な場合は除く

「困難な例?

- ・表示記号を入れる場所がない
- ・表示を入れることにより性能、機能を損なう恐れがある
- ・製造方法により表示が困難
- 4. 成形用樹脂・インキ・輸料・被覆電線はグリーンパートナー認定取引先から調達すること
- 1. This part should not contain any substances which are specified in SS-00259-1*
- 2. Clarify by delivery specifications about the existence of use of the substance which are specified in SS-00259-1*
- 3. In order to make sorting of plastic waste easy, material symbols is marked on the plastic part. For details on marking symbols, refer to SS-00195-1 "Marking of plastic parts and packaing material".

Marking may be omitted in the following casea:

- · Not enough space to apply the marking
- · Marking would interfere with performance or functional requirements
- . Marking technically not feasible due to the specific production method
- 4. Purchase ink, paint, wire rods, and molding resins only from the business partners that Sony approves as Green Partners.

*SS-00258-1: Management Standards for the Restrictively-used Substances included in Parts and Devices : 部品・デバイス等に含有される使用制限物質の管理基準



尼号	* *	日付	氏名

性 様 書 インレット A C 一 M 4 3